

## 第26届电子封装技术国际会议



PDC 8: 待定

刘 胜 教授 中国武汉大学

课程摘要:

课程大纲:

适应对象:

## 讲师简介:

刘胜,武汉大学教授,斯坦福大学博士,ASME Fellow和 IEEE Fellow,微纳制造领域专家,国内芯片封装技术的引领者,2023年当选中国科学院院士。刘胜院士在微纳制造科学与工程技术方面(涉及集成电路、发光二极管 LED、微传感器及电力电子 IGBT等芯片封装)取得了系统的创新成果。以第一完成人获2020年国家科学技术进步一等奖、2016年国家技术发明二等奖、2015年教育部技术发明一等奖、2018年电子学会技术发明一等奖、2009年 IEEE 国际电子封装学会杰出技术成就奖(全球每年1人,国内首人)、2009年中国电子学会特别成就奖、1997年国际微电子及封装学会(IMAPS)技术贡献奖、1995年美国总统教授奖(当年30人),1999年入选首批国家杰青(海外)项目(当年仅7人)。发表 SCI 论文424篇、SCI他引6600余次,出版专著6部(英文4部),授权发明专利196件。